

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过96,465,371股，每股发行价格为人民币57.83元。截至2020年12月28日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票17,793,527股，募集资金总额为人民币102,899.97万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币1,468.34万元后，实际募集资金净额为人民币101,431.63万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,770.81万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,770.81万元；（2）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币1,468.34万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币1,329.00万元，剩余不含税发行费用合计人民币139.34万元。（3）直接投入募集资金项目55,152.76万元。2021年度公司累计使用募集资金55,152.76万元，使用闲置募集资金进行现金管理37,000.00万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为9,278.87万元，募集资金专用账户利息收入1,768.26万元，合计为11,047.13万元。募集资金专户2021年12月

31日实际余额合计为11,186.47万元。二者差异系剩余不含税发行费用合计人民币139.34万元尚未支付所致。(4)截至2021年12月31日,募集资金余额合计为48,186.47万元,其中募集资金专户余额为11,186.47万元,尚未到期的现金管理产品37,000.00万元。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月15日,本公司与存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行)和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户(账号:498875522450)、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:10551301040055605)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	498875522450	10,033.26
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10551301040055605	1,153.21
合计		11,186.47

## 三、2021年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,152.76万元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2021年02月05日,公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金17,770.81万元。置换金

额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2021]230Z0181号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于2021年2月5日召开第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至2021年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否到期	期末余额 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	40,000.00	2021年2月25日	2021年5月21日	330.68	是	—
2	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2021年5月31日	2021年11月24日	340.11	是	—
3	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2021年5月31日	2021年11月24日	340.11	是	—
4	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	7天通知存款	37,000.00	2021年12月1日	—	—	否	37,000.00
5	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	16,000.00	2021年3月8日	2021年6月7日	60.49	是	—

6	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	14,000.00	2021年3月8日	2021年6月7日	157.97	是	—
7	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,100.00	2021年6月10日	2021年9月9日	57.67	是	—
8	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年6月10日	2021年9月8日	18.00	是	—
9	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	2,600.00	2021年6月10日	2021年8月31日	21.28	是	—
10	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	2,400.00	2021年6月10日	2021年8月31日	6.56	是	—
11	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年9月30日	2021年10月31日	6.80	是	—
12	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,100.00	2021年9月30日	2021年10月31日	20.26	是	—
13	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年11月26日	2021年12月30日	18.86	是	—
14	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,079.00	2021年11月26日	2021年12月30日	7.10	是	—
合计			181,979.00			1,385.89		37,000.00

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

注：公司 2021 年度募集资金理财收益金额为 1,385.89 元，与累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额 1,768.26 元差异部分系活期利息收入。

#### （五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师对度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

我们认为，后附的晶方科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶方科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐人的核查意见**

经核查，晶方科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对晶方科技在 2021 年募集资金存放与使用情况无异议。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,431.63		本年度投入募集资金总额				55,152.76			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				55,152.76			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	否	101,431.63	101,431.63	101,431.63	55,152.76	55,152.76	-46,278.87	54.37%	尚处于建设期	不适用	不适用	否	
未达到计划进度原因(分具体项目)					公司项目一方面有效提升了公司产能, 把握了智能手机、安防监控数码等领域的市场机遇, 另一方面在汽车电子领域实现了量产, 完成了新产线建设。投资进度为 54.37% 的主要原因是项目为全球首条开发建设针对车载 CIS 产品的 12 英寸 TSV 封装量产线, 对设备、材料、工艺等均需协同供应链、客户进行相应的客制化开发与创新, 新产线的运行也需相应的工艺核验-能力提升-达到稳定的过程, 目前新产线正处于量产能力提升的过程中, 要其各方面运行稳定后, 再进行后续的扩大投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二) 募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额合计为 48,186.47 万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。								
募集资金其他使用情况					无								